

2023-2029年中国晶圆行业 发展趋势与投资前景评估报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国晶圆行业发展趋势与投资前景评估报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202211/328421.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

晶圆是指制作硅半导体电路所用的硅晶片，其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入硅晶体晶种，然后慢慢拉出，形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨，抛光，切片后，形成硅晶圆片，也就是晶圆。目前国内晶圆生产线以 8 英寸和 12 英寸为主。

晶圆的主要加工方式为片加工和批加工，即同时加工 1 片或多片晶圆。随着半导体特征尺寸越来越小，加工及测量设备越来越先进，使得晶圆加工出现了新的数据特点。同时，特征尺寸的减小，使得晶圆加工时，空气中的颗粒数对晶圆加工后质量及可靠性的影响增大，而随着洁净的提高，颗粒数也出现了新的数据特点。

中企顾问网发布的《2023-2029 年中国晶圆行业发展趋势与投资前景评估报告》共十三章。首先介绍了晶圆行业市场发展环境、晶圆整体运行态势等，接着分析了晶圆行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆市场竞争格局。随后，报告对晶圆做了重点企业经营状况分析，最后分析了晶圆行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆产业有个系统的了解或者想投资晶圆行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 晶圆概述

1.1 晶圆相关概念

1.1.1 晶圆定义

1.1.2 晶圆制造

1.1.3 晶圆产业链

1.2 晶圆制造相关工艺

1.2.1 晶圆制造流程

1.2.2 热处理工艺

1.2.3 光刻工艺

1.2.4 刻蚀工艺

1.2.5 薄膜沉积工艺

1.2.6 化学机械研磨工艺

1.2.7 清洗工艺

第二章 2017-2022年国内外半导体行业发展情况

2.1 半导体产业概述

2.1.1 半导体产业概况

2.1.2 半导体产业链构成

2.1.3 半导体产业运作模式

2.1.4 集成电路制造行业

2.2 2017-2022年全球半导体市场分析

2.2.1 市场销售规模

2.2.2 产业研发投入

2.2.3 行业产品结构

2.2.4 区域市场格局

2.2.5 企业营收排名

2.2.6 市场规模预测

2.3 2017-2022年中国半导体市场运行状况

2.3.1 产业销售规模

2.3.2 产业区域分布

2.3.3 国产替代加快

2.3.4 市场需求分析

2.3.5 行业发展前景

2.4 中国半导体产业发展问题分析

2.4.1 产业发展短板

2.4.2 技术发展壁垒

2.4.3 贸易摩擦影响

2.4.4 市场垄断困境

2.5 中国半导体产业发展措施建议

2.5.1 产业发展战略

2.5.2 产业发展路径

2.5.3 研发核心技术

2.5.4 人才发展策略

2.5.5 突破垄断策略

第三章 2017-2022年国际晶圆产业发展综况

3.1 全球晶圆制造行业发展情况

3.1.1 晶圆制造投资分布

3.1.2 晶圆制造设备市场

3.1.3 企业晶圆产能排名

3.1.4 晶圆细分市场份额

3.2 全球晶圆代工市场发展

3.2.1 全球晶圆代工市场规模

3.2.2 全球晶圆代工地区分布

3.2.3 全球晶圆代工市场需求

3.3 全球晶圆代工产业格局

3.3.1 全球晶圆代工企业排名

3.3.2 晶圆代工TOP10企业

3.3.3 晶圆二线专属代工企业

3.3.4 IDM兼晶圆代工企业

3.4 中国台湾地区晶圆产业发展情况

3.4.1 台湾晶圆产业发展地位

3.4.2 台湾晶圆产业发展规模

3.4.3 台湾晶圆代工产能分析

3.4.4 台湾晶圆代工竞争格局

3.4.5 台湾晶圆代工需求趋势

第四章 2017-2022年中国晶圆产业发展环境分析

4.1 政策环境

4.1.1 产业扶持政策

4.1.2 税收利好政策

4.1.3 支持进口政策

4.2 经济环境

4.2.1 宏观经济概况

4.2.2 工业经济运行

4.2.3 对外经济分析

- 4.2.4 固定资产投资
- 4.2.5 宏观经济展望
- 4.3 社会环境
 - 4.3.1 研发投入情况
 - 4.3.2 从业人员情况
 - 4.3.3 行业薪酬水平

第五章 2017-2022年中国晶圆产业发展综述

- 5.1 中国IC制造行业发展
 - 5.1.1 行业发展特点
 - 5.1.2 行业发展规模
 - 5.1.3 市场竞争格局
 - 5.1.4 设备供应情况
 - 5.1.5 行业发展趋势
- 5.2 中国晶圆产业发展分析
 - 5.2.1 晶圆产业转移情况
 - 5.2.2 晶圆制造市场规模
 - 5.2.3 晶圆厂布局走向
- 5.3 中国晶圆厂生产线发展
 - 5.3.1 12英寸生产线
 - 5.3.2 8英寸生产线
 - 5.3.3 6英寸生产线
- 5.4 中国晶圆代工市场发展情况
 - 5.4.1 晶圆代工市场规模
 - 5.4.2 晶圆代工公司
 - 5.4.3 晶圆代工市场机会
- 5.5 中国晶圆产业发展面临挑战及对策
 - 5.5.1 行业发展不足
 - 5.5.2 行业面临挑战
 - 5.5.3 行业发展对策

第六章 2017-2022年晶圆制程工艺发展分析

- 6.1 晶圆制程主要应用技术
 - 6.1.1 晶圆制程逻辑工艺技术
 - 6.1.2 晶圆制程特色工艺技术
 - 6.1.3 不同晶圆制程应用领域
 - 6.1.4 晶圆制程逻辑工艺分类
 - 6.1.5 晶圆制程工艺发展前景
- 6.2 晶圆先进制程发展分析
 - 6.2.1 主要先进制程工艺
 - 6.2.2 先进制程发展现状
 - 6.2.3 先进制程产品格局
 - 6.2.4 先进制程晶圆厂分布
- 6.3 晶圆成熟制程发展分析
 - 6.3.1 成熟制程发展优势
 - 6.3.2 成熟制程应用现状
 - 6.3.3 成熟制程企业排名
 - 6.3.4 成熟制程代表企业
 - 6.3.5 成熟制程需求趋势
- 6.4 晶圆制造特色工艺发展分析
 - 6.4.1 特色工艺概述
 - 6.4.2 特色工艺特征
 - 6.4.3 市场发展现状
 - 6.4.4 市场需求前景

第七章 2017-2022年晶圆产业链上游——硅片产业发展情况

- 7.1 半导体硅片概述
 - 7.1.1 半导体硅片简介
 - 7.1.2 硅片的主要种类
 - 7.1.3 半导体硅片产品
 - 7.1.4 半导体硅片制造工艺
 - 7.1.5 半导体硅片技术路径
 - 7.1.6 半导体硅片制造成本
- 7.2 全球半导体硅片发展分析

- 7.2.1 全球硅片产业情况
- 7.2.2 全球硅片价格走势
- 7.2.3 主要硅片产商布局
- 7.2.4 全球硅片企业收购
- 7.3 国内半导体硅片行业发展分析
 - 7.3.1 国内硅片发展现状
 - 7.3.2 国内硅片需求分析
 - 7.3.3 国内主要硅片企业
 - 7.3.4 硅片主要下游应用
 - 7.3.5 国产企业面临挑战
- 7.4 硅片制造主要壁垒
 - 7.4.1 技术壁垒
 - 7.4.2 认证壁垒
 - 7.4.3 设备壁垒
 - 7.4.4 资金壁垒
- 7.5 半导体硅片行业发展展望
 - 7.5.1 技术发展趋势
 - 7.5.2 市场发展前景
 - 7.5.3 国产硅片机遇

第八章 2017-2022年晶圆产业链中游——晶圆制造设备发展

- 8.1 光刻设备
 - 8.1.1 光刻机种类
 - 8.1.2 光刻机主要构成
 - 8.1.3 光刻机技术迭代
 - 8.1.4 光刻机发展现状
 - 8.1.5 光刻机竞争格局
 - 8.1.6 光刻机产品革新
 - 8.1.7 国产光刻机发展
- 8.2 刻蚀设备
 - 8.2.1 刻蚀工艺简介
 - 8.2.2 刻蚀机主要分类

- 8.2.3 刻蚀设备发展规模
- 8.2.4 刻蚀加工需求增长
- 8.2.5 全球刻蚀设备格局
- 8.2.6 国内主要刻蚀企业
- 8.3 薄膜沉积设备
 - 8.3.1 薄膜工艺市场规模
 - 8.3.2 薄膜工艺市场份额
 - 8.3.3 薄膜设备国产化进程
- 8.4 清洗设备
 - 8.4.1 清洗设备技术分类
 - 8.4.2 清洗设备市场规模
 - 8.4.3 清洗设备竞争格局
 - 8.4.4 清洗设备发展趋势

第九章 2017-2022年晶圆产业链中游——晶圆先进封装综述

- 9.1 先进封装基本介绍
 - 9.1.1 先进封装基本含义
 - 9.1.2 先进封装发展阶段
 - 9.1.3 先进封装系列平台
 - 9.1.4 先进封装影响意义
 - 9.1.5 先进封装发展优势
 - 9.1.6 先进封装技术类型
 - 9.1.7 先进封装技术特点
- 9.2 先进封装关键技术分析
 - 9.2.1 堆叠封装
 - 9.2.2 晶圆级封装
 - 9.2.3 2.5D/3D技术
 - 9.2.4 系统级封装SiP技术
- 9.3 中国先进封装技术市场发展现状
 - 9.3.1 先进封装市场发展规模
 - 9.3.2 先进封装产能布局分析
 - 9.3.3 先进封装技术份额提升

- 9.3.4 企业先进封装技术竞争
- 9.3.5 先进封装企业营收状况
- 9.3.6 先进封装技术应用领域
- 9.3.7 先进封装技术发展困境
- 9.4 中国芯片封测行业运行状况
 - 9.4.1 市场规模分析
 - 9.4.2 主要产品分析
 - 9.4.3 企业类型分析
 - 9.4.4 企业市场份额
 - 9.4.5 区域分布占比
- 9.5 先进封装技术未来发展空间预测
 - 9.5.1 先进封装技术趋势
 - 9.5.2 先进封装前景展望
 - 9.5.3 先进封装发展趋势
 - 9.5.4 先进封装发展战略

第十章 2017-2022年晶圆产业链下游应用分析

- 10.1 车用芯片
 - 10.1.1 车载芯片基本介绍
 - 10.1.2 车载芯片需求特点
 - 10.1.3 车用晶圆需求情况
 - 10.1.4 车企布局晶圆厂动态
 - 10.1.5 车载芯片供应现状
 - 10.1.6 车用芯片市场潜力
 - 10.1.7 车载芯片发展走势
- 10.2 智能手机芯片
 - 10.2.1 智能手机芯片介绍
 - 10.2.2 智能手机芯片规模
 - 10.2.3 智能手机出货情况
 - 10.2.4 手机芯片制程工艺
 - 10.2.5 手机芯片需求趋势
- 10.3 服务器芯片

- 10.3.1 服务器芯片发展规模
- 10.3.2 服务器芯片需求现状
- 10.3.3 服务器芯片市场格局
- 10.3.4 国产服务器芯片发展
- 10.3.5 服务器芯片需求前景
- 10.4 物联网芯片
 - 10.4.1 物联网市场规模
 - 10.4.2 物联网芯片应用
 - 10.4.3 国产物联网芯片发展
 - 10.4.4 物联网芯片竞争格局
 - 10.4.5 物联网芯片发展预测

第十一章 国内外晶圆产业重点企业经营分析

- 11.1 台湾积体电路制造公司
 - 11.1.1 企业发展概况
 - 11.1.2 企业产能情况
 - 11.1.3 先进制程布局
 - 11.1.4 企业经营状况分析
- 11.2 联华电子股份有限公司
 - 11.2.1 企业发展概况
 - 11.2.2 企业产能情况
 - 11.2.3 先进制程布局
 - 11.2.4 企业经营状况分析
- 11.3 中芯国际集成电路制造有限公司
 - 11.3.1 企业发展概况
 - 11.3.2 主要业务分析
 - 11.3.3 企业经营模式
 - 11.3.4 经营效益分析
- 11.4 华虹半导体有限公司
 - 11.4.1 企业发展概况
 - 11.4.2 企业业务分析
 - 11.4.3 企业经营状况分析

- 11.4.4 企业产能情况
- 11.5 华润微电子有限公司
 - 11.5.1 企业发展概况
 - 11.5.2 晶圆制造业务
 - 11.5.3 经营模式分析
 - 11.5.4 经营效益分析
- 11.6 其他企业
 - 11.6.1 上海先进半导体制造有限公司
 - 11.6.2 和舰芯片制造（苏州）股份有限公司
 - 11.6.3 联芯集成电路制造(厦门)有限公司

第十二章 晶圆产业投融资分析

- 12.1 集成电路产业投资基金发展
 - 12.1.1 大基金发展相关概况
 - 12.1.2 大基金投资企业模式
 - 12.1.3 大基金一期发展回顾
 - 12.1.4 大基金二期发展现状
 - 12.1.5 大基金二期布局方向
- 12.2 晶圆产业发展机遇分析
 - 12.2.1 晶圆行业政策机遇
 - 12.2.2 晶圆下游应用机遇
 - 12.2.3 晶圆再生发展机会
- 12.3 晶圆制造项目投资动态
 - 12.3.1 名芯半导体晶圆生产线项目
 - 12.3.2 闻泰科技车用晶圆制造项目
 - 12.3.3 百识半导体6寸晶圆制造项目
 - 12.3.4 杰利大功率半导体晶圆项目
- 12.4 晶圆产业投融资风险
 - 12.4.1 研发风险
 - 12.4.2 竞争风险
 - 12.4.3 资金风险
 - 12.4.4 原材料风险

第十三章 2023-2029年中国晶圆产业发展前景及趋势预测分析

13.1 晶圆产业发展趋势展望

13.1.1 全球晶圆厂发展展望

13.1.2 全球晶圆代工发展趋势

13.1.3 全球晶圆细分产品趋势

13.1.4 中国晶圆代工发展趋势

13.2 2023-2029年中国晶圆产业预测分析

13.2.1 2023-2029年中国晶圆产业影响因素分析

13.2.2 2023-2029年中国晶圆产业规模预测

图表目录

图表 每5万片晶圆产能的设备投资

图表 晶圆行业产业链

图表 氧化工艺的用途

图表 光刻工艺流程图

图表 光刻工艺流程

图表 等离子刻蚀原理

图表 湿法刻蚀和干法刻蚀对比

图表 离子注入与扩散工艺比较

图表 离子注入机示意图

图表 离子注入机细分市场格局

图表 IC集成电路离子注入机市场格局

图表 三种CVD工艺对比

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202211/328421.html>